证券代码：688401　　证券简称：路维光电

转债代码：118056　　转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研　☑ 分析师会议 ☐ 媒体采访　☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会　☐ 路演活动 ☐ 现场调研　☑ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称	国盛证券策略会、长江证券、中信证券、中信建投、中金公司、国泰海通、申万宏源、开源证券、长城证券、兴业证券、金元证券、太平洋证券、招商证券、世纪证券、山西证券、光大证券、天风证券、国联民生电子、国海电子、国金电子、中泰电子、长城通信、开源证券权益投资部、天风转债、申万固收、国泰君安资管、招商资管、中泰资管、华泰证券资管、天风资管、Macquarie Capital、浙商基金、银河基金、长城基金、宏利基金、东方红资管、兴业基金、创金合信、南方基金、信达澳亚、华安基金、平安基金、东方基金、申万菱信、诺安基金、东方阿尔法、嘉实基金、光大保德信、德邦基金、合远基金、淳厚基金、大成基金、长信基金、诺德基金、国寿安保、易方达基金、华夏基金、银华基金、民生加银、汇添富、富安达基金、前海开源、华宝基金、圆信永丰、鹏华基金、国联安基金、中欧基金、国海富兰克林、融通基金、建信基金、海富通、汇丰晋信、中航基金、国泰基金、江信基金、泰康基金、中银基金、华泰保兴、泓德基金、睿远基金、国寿养老、平安养老、太平养老、东吴人寿、太保资产、太平资产、人保资产、华夏久盈、工银安盛资管、安联资管、大家资产、华泰资产、长城财富、建信理财、招银理财、华夏理财、景林资

	产、鑫垣资产、道仁资产、榕树投资、鹏山资产、玄卜投资、金之灏基金、正圆投资、宁泉资产、巨杉资产、非马投资、昊青咨询、IDG 资本、长沙高新炜德基金、汇杰达理、北京国有资本运营、国新投资
调研时间	2026 年 11 月 2 日-2026 年 11 月 4 日
会议地点	公司会议室、进门财经、国金证券策略会会场
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘　鹏 先生 投资者关系总监：刘文鑫 女士
投资者关系活动内容记录	**1、公司简单介绍 2026 年三季度整体业绩情况** 2026 年前三季度，公司实现营业收入 97,491.68 万元，较上年同期增加 17.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,574.50 万元，较上年同期增加 25.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,130.37 万元，较上年同期增加 29.38%。盈利能力来看，2026 年前三季度公司毛利率达到 36.10%，同比增长 1.49 个百分点，净利率 22.12%，同比增长 1.45 个百分点。 单三季度来看，公司 2026 年三季度实现营收 3.07 亿元，同比增长 8.44%；归母净利润 7119.41 万元，同比增长 8.98%；扣非净利润 6507.96 万元，同比增长 7.48%。盈利能力来看，2026 年三季度毛利率 37.88%，同比增长 1.48 个百分点；净利率 23.19%，同比增长 0.10 个百分点。 本次三季度报告披露后，公司也关注到市场和投资者对公司阶段性经营表现的一些关切。客观来说，三季度的经营业绩确实面临一定压力，与部分投资者此前的预期存在一定差距。三季度收入同比增长有降速，环比二季度收入利润也有一些下滑，公司深刻分析了一下原因，一是目前三季度面板的需求还没有真正释放出来，尤其是 8.6 代 OLED，面板厂在产线拉通后并没有很快释放出较多的开模需求，但公司认为后续这个因素会逐渐得到缓解；此外三季度超大尺寸的接单在之前透支，因此三季度 G11 的接单也相对平淡；三是三季度没有特别多的新增产能释放，三季度收入主要体现了 6、7、8 月的出货，厦门工厂的部分设备到位略有延期，因此相应设备在三季度没有释放产

	能。 公司持续推进对下游客户新产品的送样验证情况，同时针对一些此前份额相对较低的下游客户付出了更多的努力，希望可以在未来给大家拿出更好的成绩，感谢大家一直以来的关注和支持！ **2、路芯半导体进展如何？** 公司投资建设的路芯半导体掩膜版项目进展顺利，制程节点布局居于国内厂商前列。该项目一期产品覆盖至 40nm 制程节点半导体掩膜版，2025 年已逐步实现产品量产，实现 90nm 及以上成套掩膜版客户端验证通过并供货，40nm 和 28nm 单片掩膜版客户端验证通过并供货，2026 年公司 90nm 成套掩膜版获得了更多下游客户的验证通过，并持续推进 40nm 成套掩膜版客户端送样工作；二期规划向 28nm 至 14nm 节点延伸，计划于 2026 年陆续投建。未来伴随项目的顺利投产，其产品将逐步覆盖 MCU（微控制芯片），SiPh（硅光子）、CIS（互补金属氧化物半导体图像传感器），BCD（双极-互补-双扩散-金属氧化物半场效应管），DDIC（显示驱动芯片），MS/RF（混合射频信号），Embd. NVM（嵌入式非易失存储器），NOR/NAND Flash（非易失闪存），DRAM（动态随机存取存储器）等半导体制造相关行业，进一步完善产业链供给、推动国产替代进程。 **3、厦门路维预计何时投产？** 厦门路维总投资额为人民币 20 亿元，计划建设 11 条高端光掩膜版产线，重点研发生产 G8.6 及以下各类高精度光掩膜版，项目已于 2025 年 7 月完成奠基仪式，2026 年 1 月封顶。项目分阶段实施，其中一期计划总投资额 13 亿元，将建设 5 条 G8.6 及以下 AMOLED 高精度掩膜版产线，配置 5 台（套）核心主设备及 22 台（套）精密辅助设备。目前，项目一期设备已经开始陆续进场调试，预计于 2026 年下半年陆续投产。该项目投产后，公司产能将显著提升，能够更充分地满足下游客户需求，助力公司持续提升在客户供应链中的份额，加速推进国产化替代进程，进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。 **4、公司持续推进半导体掩膜版先进制程布局，并已通过投资路**

	芯半导体拓展产业能力。请问在高精度掩膜版、关键材料及核心工艺设备领域，是否存在通过外部股权投资或控股并购补充成熟技术、产品及产业能力的实际需求？ 公司始终重视半导体掩膜版产业链的协同发展，并持续围绕主营业务推进先进制程布局。通过投资路芯半导体，公司也在积极探索产业资源整合与技术能力协同的路径，进一步拓展产业布局。 从行业发展趋势来看，高精度掩膜版涉及材料、设备、工艺及配套技术等多个环节，产业链各环节的技术突破与协同发展，对于提升公司产品竞争力和整体产业能力具有重要意义。 在产业布局方面，公司将立足自身发展战略和主营业务需求，持续关注高精度掩膜版、关键材料及核心工艺设备等领域的技术发展和产业机会。对于能够与公司现有业务形成技术协同、产品互补及产业链协同效应的优质投资或并购标的，公司将保持开放态度，并结合技术成熟度、商业化能力、估值水平及投资回报等因素进行审慎评估。 未来，公司将坚持以内生发展与外延协同相结合的方式，持续完善产业布局，提升核心竞争力。若涉及达到信息披露标准的重大事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 **5、40nm 成套掩膜板预计什么时候通过验证？** 公司 40nm 成套掩膜版相关产品正在积极推进客户验证工作，后续验证进度主要取决于客户的测试安排、工艺适配情况及验证反馈。由于不同客户的验证流程、测试周期及评价标准存在一定差异，因此目前尚无法准确预计具体通过验证的时间。公司将持续与客户保持密切沟通，积极配合客户开展相关测试及验证工作，并根据客户反馈持续优化产品和工艺。公司也将积极推进先进制程掩膜版产品的研发及产业化进程，争取早日实现相关产品的验证突破和市场应用。 **6、存储行业扩产对掩膜版的影响？** 存储制程的微缩与 3D 堆叠直接推高了掩膜版的技术门槛与价值。以 3D NAND 为例，其层数增加本质是存储单元在垂直方向的堆叠增加，技术上主要通过重复性的薄膜沉积与高深宽比刻蚀实现，随

	着堆叠层数提升，通孔（channel hole）、阶梯结构（staircase）及字线切割等关键结构的加工难度大幅提升，对光刻精度、套刻控制、多重曝光及 OPC 复杂度提出更高要求，从而推动关键层掩膜版技术门槛与单价水平上升。此外，3D NAND 产品代际迭代速度加快（如 128L、176L、232L 持续演进），每一代新产品均需重新开发整套掩膜版，形成换代驱动的持续需求来源。 相较之下，DRAM 的工艺演进路径以线宽缩小与结构复杂化为主，从 DDR4 向 DDR5 乃至 HBM 升级过程中，光刻层数及关键层数量均呈现更为直接的增加趋势，同时 EUV 等先进光刻技术的导入显著提升单张掩膜版的制造难度与价值量，使得掩膜版需求不仅体现为用量增长，更体现为价格中枢的上移。进一步来看，AI 驱动的数据中心需求显著提升单位服务器对 DRAM 及 NAND 的用量（如高带宽存储需求放大），通过提升晶圆开工率间接放大掩膜版消耗，形成需求的“放大器”。从价格形成机制看，掩膜版单价主要由技术节点与关键层复杂度决定，NAND 由于结构重复性较强，其价格提升相对温和，而 DRAM 在先进制程及 EUV 导入背景下价格弹性更为显著。 国产存储厂商的技术突破与规模化量产，为国产掩膜版企业提供了稀缺且至关重要的验证平台与增量市场，成为推动掩膜版国产替代的关键驱动力。一方面，以长江存储和长鑫存储为代表的本土厂商，在先进工艺持续推进过程中，对掩膜版在分辨率、套刻精度、缺陷控制及稳定性等方面提出了国际性的要求，使得国产掩膜版厂商能够在真实量产环境中完成从研发验证到工程化应用的能力跃迁，实现技术水平与产品可靠性的双重验证；另一方面，存储芯片作为掩膜版需求规模最大、工艺最复杂的应用领域之一，其本土化供应链的逐步建立，为国产掩膜版企业带来了持续、稳定且具备规模效应的订单，进而形成正向循环。 综合来看，国产存储的崛起不仅在“量”的层面扩大了掩膜版市场空间，更在“质”的层面推动了国产掩膜版技术能力的跃升与应用边界的拓展，成为加速掩膜版在存储芯片这一核心应用领域实现国产

	替代的关键驱动力。 **7、近期股价波动明显，公司是否会采取一些市值管理手段例如回购注销等进行维护？** 公司高度重视股东利益和投资者回报，也充分理解投资者对于公司近期股价表现的关切。此前，公司已披露董事长个人的增持计划，董事长以实际行动表达了对公司未来发展前景和长期投资价值的信心，也体现了管理层对公司持续发展的坚定态度。 关于公司层面的股份回购，公司将结合自身经营情况、财务状况、未来发展规划及资本市场环境，审慎研究和评估包括股份回购在内的资本市场工具的适用性。 公司认为，市值管理的核心在于持续提升公司内在价值。未来，公司将继续聚焦主营业务发展，提升经营质量和核心竞争力，同时做好投资者关系管理和股东回报相关工作，努力实现公司长期价值与股东利益的协调发展。如后续涉及股份回购等重大事项，公司将严格按照相关法律法规及监管要求履行决策程序和信息披露义务。 **8、公司在 PSM 以及 HTM 领域的进展？** 在半色调掩膜版（HTM）领域，公司的技术演进路径清晰且扎实。从 2018 年实现 G2.5 等中小尺寸半色调掩膜版的量产突破起步，次年便将能力边界迅速扩展至 G8.5 及 G11 TFT-LCD 产品。至 2024 年，公司进一步跨越技术门槛，成功量产 AMOLED 用 HTM 产品，至此形成了覆盖全世代线的半色调产品矩阵，彻底结束了该细分市场长期由海外厂商供应的局面。 在相移掩膜版（PSM）领域，公司沿着从基础研发到多场景量产的路径稳步推进。2021 年完成衰减型相移掩膜版（ATT PSM）的核心工艺开发并通过内部验证后，公司加速推动技术成果向实际应用转化：2023 年，Metal Mesh 用 PSM 产品率先导入量产；2024 年，彩色滤光片用 PSM 产品完成客户认证并顺利投放市场。TFT-Array 用 PSM 掩膜版已贯通关键工艺节点，已于 2025 年实现客户验证通过，并在 2026 年上半年实现多个客户、不同功能层产品的导入；与此同时，面

	向更高精度，如 AMOLED 用 PSM 产品的研发也在积极推进中，将依据下游客户的技术路线迭代和市场需求择机推向量产。 **9、请问公司半导体掩膜版制程拓展到 14nm 了吗？现有的半导体掩膜版制程技术是否处于国内领先水平？** 路芯半导体二期项目预计将半导体掩膜版制程推进至 14nm，目前正处于筹资采购设备阶段，目前路芯可以稳定生产的节点是 28nm 的单片掩膜版，用于光刻机厂商的测试等环节，已经于 2025 年稳定供应给下游客户，在国内可比上市公司中居于领先地位。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
风险提示	以上内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单	无